

2018年5月7日

## サイプレス、2018年度第1四半期の業績を発表

組み込みソリューションのリーダーであるサイプレス セミコンダクタ社 (米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ: CY) は2018年4月26日 (米国時間)、2018年度第1四半期の業績を発表しました。

- 売上高は5億8,220万ドルで前年比9.5%増
- GAAP および非 GAAP の粗利益率はそれぞれ36.5%と45.9%で、前年比7.00ポイントと6.60ポイントの上昇
- GAAP の希薄化後 EPS (1株当たり利益) は前年比で15セント改善して0.02ドルに、非 GAAP の希薄化後 EPS は14セント改善して0.27ドルに増加
- 車載市場での売上高が前年比で14.8%増加

サイプレスの社長兼最高経営責任者である Hassane El-Khoury は、「サイプレスの事業は当四半期も堅調で、財務面、業務面ともに好業績を達成しました。Cypress 3.0 戦略に注力した結果、前年比で売上高は9.5%増、1株当たり利益は2倍を超える増加となりました。当四半期には、ハードウェアおよびソフトウェアでいくつかのイノベーションを導入し、組み込みソリューションのポートフォリオを拡充しました。それによりサイプレスはパートナー各社と共に、民生および産業、車載機器のさまざまな規模の顧客企業が抱える問題を解決することが可能となり、さらに、当社ではさまざまな製品をクロスセルする能力が拡大しました。当社のイノベーション力は、市場を動かささまざまな企業から受注によって記録的な売上高を達成しているという事実によって明確に実証されており、同時に、総顧客企業数が大幅に増えていることで当社の Go-Broad 戦略 (顧客ベースの拡張戦略) の努力が実証されています」と述べています。

当四半期の売上高および利益を過去の比較数値と併せて以下に示します。

(単位:千、ただし1株当たりの数値を除きます)

	GAAP <sup>1</sup>			非 GAAP <sup>2</sup>		
	2018年度 第1四半期	2017年度 第4四半期	2017年度 第1四半期	2018年度 第1四半期	2017年度 第4四半期	2017年度 第1四半期
売上高	\$582,241	\$597,547	\$531,874	\$582,241	\$597,547	\$531,874
粗利益率	36.5%	37.2%	29.5%	45.9%	45.4%	39.3%
営業利益率	6.1%	7.0%	(2.6)%	19.5%	20.2%	12.2%
純利益 (損失)	\$9,078	\$(34,012)	\$(42,999)	\$100,296	\$104,686	\$45,887
希薄化後 EPS (損失)	\$0.02	\$(0.10)	\$(0.13)	\$0.27	\$0.28	\$0.13

1. 2018年度第1四半期には、一定の費用が売上原価の一部として分類変更されました。過去の業績は、2018年度第1四半期の表示に合わせて調整されています。
2. 詳細は英文リリースの「GAAP 財務指標から非 GAAP 財務指標への調整について」の諸表 (「非 GAAP 業績」の諸表) を参照してください。

## 事業レビュー

- サイプレスは当四半期に、ワイヤレス コネクティビティのソリューションにおける重要な進展を発表しました。ModusToolbox™ソフトウェア スイートをリリースし、開発者は、この直感的なプラットフォームを使用して魅力的な IoT 製品を記録的短時間で開発できます。また、サイプレスの 802.11ac コンボ ソリューションを搭載した新しい Raspberry Pi 3 Model B+開発者用ボードが発表されました。この製品は、IoT 製品開発者に信頼性の高い相互接続性を実現する超高速 Wi-Fi®接続を提供します。
- 車載市場では、先進運転支援システム (ADAS) などのアプリケーション向けに、ミッション クリティカルなデータのログ記録問題を解決する高性能不揮発性メモリ製品ファミリの Excelon™を発売しました。また、Audi 社と Elektrobit 社の合弁会社である e.solutions GmbH 社が、新たな車両内通信装置の設計にサイプレスのワイヤレス接続ソリューションを搭載したことを発表しました。この装置は 2018 年型 Audi A8 などに採用されます。このソリューションは、複数デバイスへの接続と、各デバイスへ別々のコンテンツを同時ストリーミングが可能になるサイプレスの RSDB (Real Simultaneous Dual Band) 車載グレード Wi-Fi & Bluetooth®コンボ ソリューションをベースとしています。
- またサイプレスは、誘導性センシングによってメタリックを使用した表面デザインの情報検知を可能にする新しい PSoC® 4700S マイクロコントローラー (MCU) をリリースしセンシング ソリューションを拡充しました。このデバイスにより、メタル素材を使用した外観の美しい製品を設計し他社製品との差異化を達成できるようになります。
- サイプレスは、総額 3,940 万ドル、1 株当たり 0.11 ドルの現金配当金を、2018 年 3 月 29 日の営業終了時の当社普通株式の登録保有者に 2018 年 4 月 19 日に支払いました。この配当金は、2018 年 3 月 29 日時点で年間益回り 2.6%に相当します。

## 売上高概要

(単位:千、ただし%を除きます)

(未監査)

	四半期			前四半期比	前年同期比
	2018 年 4 月 1 日 締め	2017 年 12 月 31 日 締め	2017 年 4 月 2 日 締め		
<b>ビジネス ユニット</b>					
MCD	\$336,710	\$357,247	\$317,901	(6)%	6%
MPD	\$245,531	\$240,300	\$213,973	2%	15%
合計	\$582,241	\$597,547	\$531,874	(3)%	9%
<b>最終市場</b>					
産業	18%	17%	20%	2%	(1)%
車載	34%	30%	33%	11%	15%
民生	31%	35%	34%	(13)%	—
エンタープライズ	17%	18%	13%	(10)%	37%
合計	100%	100%	100%	—%	—%

1. マイクロコントローラーおよびコネクティビティ部門 (「MCD」) には、マイクロコントローラー、コネクティビティ、USB の製品が含まれ、メモリ製品部門 (「MPD」) には、RAM、フラッシュ、AgigA Tech 製品が含まれます。

## 2018 年度第 2 四半期の財務見通し

サイプレスの 2018 年度第 2 四半期における財務業績は、次の通りとなる見通しです。

	GAAP	非 GAAP
売上高	6 億 500 万ドル～6 億 3,000 万ドル	
粗利益率 (%)	36.0%～37.0%	45.5%～46.5%
希薄化後 EPS	\$0.01 ～ \$0.04	\$0.27 ～ \$0.31

非 GAAP 財務指標および将来予測の記述につきましては、原文リリース (英語) を参照してください。

再編費用、資産減損、繰延報酬資産および負債の価額の変化、株式付与の変更による株式報酬の影響、非 GAAP 調整の税金への影響など、GAAP 財務指標の推定に必要な特定の重要項目の時期と額は本質的に予想不可能なものであるか、当社の統制が及ばないものであり、当社の財務業績に大きな影響を与えることがあります。したがって、2018 年度第 2 四半期見通しの一部として含まれているそのような非 GAAP 財務指標に関して、最も直接的に比較可能な GAAP 指標に対する完全な数量的調整を提示することは、非常な労力なくして不可能であり、2018 年度第 2 四半期の非 GAAP 業績で追加の調整が行われる可能性があります。サイプレスは、下記の「非 GAAP 財務指標」のセクションにおいて、非 GAAP 財務指標と最も直接的比較可能な GAAP 指標との間に予想される差異について定性的に説明しています。

### サイプレスとつながろう

- Twitter: [@NipponCypress](#)
- Facebook: [CypressJapan](#)

### サイプレスについて

サイプレスは、世界で最も革新的な車載や産業機器、ホーム オートメーションおよび家電、民生機器および医療機器製品向けに、最先端の組み込みシステム ソリューションを提供するリーディング カンパニーです。サイプレスのプログラマブル システムオンチップや汎用マイコン、アナログ IC、ワイヤレスおよび USB ベースのコネクティビティ ソリューション、高い信頼性と高性能を提供するメモリ製品は、差別化製品の開発と早期市場参入を支援します。サイプレスは、ベストクラスのサポートとエンジニアリング リソースをグローバルに提供し、世界各国のイノベーターおよび独創的なユーザーが、従来市場を破壊しまったく新しい製品カテゴリを歴史的なスピードで市場投入できるよう支援します。詳細はサイプレスのウェブサイト ([japan.cypress.com](http://japan.cypress.com)) をご覧ください。

###

Cypress や Cypress のロゴは、サイプレス セミコンダクタ社の登録商標です。その他すべての名称は、それぞれの所有者に帰属します。

### サイプレスお問い合わせ先:

サイプレス セミコンダクタ [info-japan@cypress.com](mailto:info-japan@cypress.com)